

MLS-G

- MLS-GはHTE銅箔規格の一般特性を保有したS面(光沢面)粗化処理銅箔です。
良好なエッティング特性を実現させ、ファインパターン内層用及びビルドアップ用銅箔に適しております。
- MLS-G has passed through reverse side treatment process. It has the same general properties as HTE(STD) foils with better pattern reliability, ensuring good performance in fine line patterning for inner and build-up layers.
- MLS-Gは低粗度のため高速伝送配線板に適した材料です。
Very low profile of MLS-G makes it an excellent material to apply to high speed transmission board.

用途/Application

- ・HDIマイクロビア配線板
/High Density Interconnect(HDI)
- ・高速伝送配線板
/HSD (High speed digital)
- ・基地局/サーバー
/Base station / Server

構成/Composition



生産拠点/Production Site

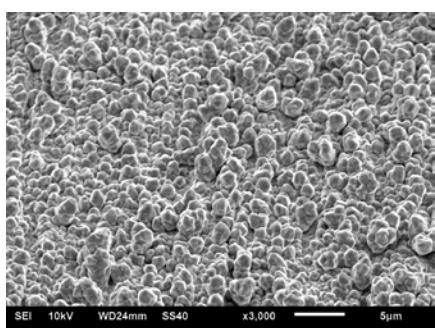
- ・台湾 / Taiwan
- ・マレーシア / Malaysia

代表的特性値/Representative data

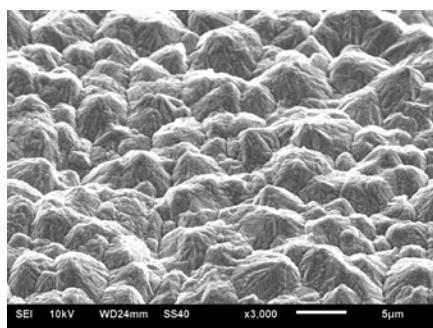
	μ m	R _z (μ m)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm)
MLS-G	12	3.0	370	6	0.9
	18	3.0	370	8	1.0
	35	3.0	370	16	1.3
	70	3.0	300	19	1.5

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。
This is representative date, not guarantee.

ラミ面/Laminate side



レジ面/ Resist side



MLS-G

STD. type heavy foil series

- MW-G厚銅は環境に配慮した大電流配線板に適した銅箔です。
MLS-G heavy copper foil comply with environment regulation is suitable for use in high current board design.
- 処理面が低粗度のため薄いコア材料に適しております。
Bonding side with very low roughness is excellent to apply to thin core laminate.
- 安定した生産能力はお客様のご要望を満足します。
Our plant has stable capacity for MLS-G to fulfill customer requirements.

用途/Application

- 車載配線板
/Automotive board
- 電源配線板
/Power supply unit
- 基地局
/Base station

構成/Composition



生産拠点/Production Site

- 台灣 / Taiwan

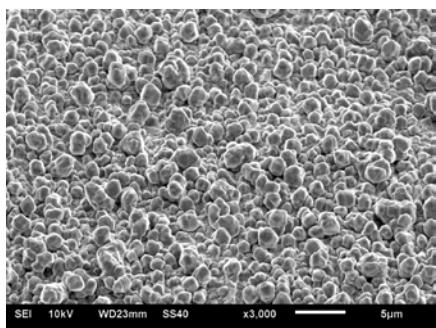
代表的特性値/Representative data

	μ m	Rz (μ m)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm)
MLS-G	105	3.0	300	15	2.0
	140	3.0	300	15	2.1
	175	3.0	300	15	2.2
	210	3.0	300	15	2.4

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。

This is representative date, not guarantee.

ラミ面/Laminate side



レジ面/ Resist side

